

第 12 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 27 年 12 月 1 日(火) 10:30~16:30

場所:日本橋ライフサイエンスビルディング 2 階 201 大会議室 (東京都中央区)

時間	題 目	講 演 者
	司会 豊田 良孝 (千住金属工業(株))	
10:30~ 11:50	『高熱伝導・熱応力緩和性を有する アルミニウム/グラファイト積層ロール型複合材』 (40 分)	(株)豊田中央研究所 ○山田 由香, 北條 浩, 木村 英彦, 川本 敦史, 松森 唯益, 近藤 継男
	『高密度実装を支えるプリント配線板の 部品内蔵技術と微細配線技術』 (40 分)	北海道科学大学 ○見山 克己
11:50~ 12:50	昼 食 休 憩	
12:50~ 13:00	委 員 会 議 事	
	司会 柴崎 正訓 ((株)タムラ製作所)	
13:00~ 15:00	『異方導電性接合材料の開発』 (40 分)	(株)タムラ製作所 ○三木 禎大, 岡田 直記, 西川 大英, 島田 利昭, 清田 達也
	『WLCSP 用はんだボール材料の開発』 (40 分)	千住金属工業(株) ○野村 光, 立花 賢, 吉川 俊策
	『鉛フリーはんだによる高信頼性 アルミ接合技術』 (40 分)	(株)日本スペリア社 ○不可三 拓郎, 宮岡 志典, 末永 将一, 澤田 脩平, 西村 貴利, 西村 哲郎
15:00~ 15:10	休 憩	
	司会 山内 啓 (群馬工業高等専門学校)	
15:10~ 16:30	『AI部材の接合面積拡大に及ぼす 有機酸を用いた表面処理効果に関する検討』 (40分)	矢崎総業(株) ○杉山 善崇, 山形 由紀, 勝又 文治, 高橋 宏和 群馬大学 小山 真司
	『車載対応はんだクラック抑制 基板材料「TD-002」』 (40分)	日立化成(株) ○富岡 健一, 北嶋 貴代

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。